

(<https://www.digitimes.com.tw/tech/webad/click.asp?Seq=61966&ord=>)
(<https://www.digitimes.com.tw/tech/webad/click.asp?Seq=61624&clickkeyword=&ord=>)

物聯網 (/iot/) / 產品應用服務 (product_50.asp?cat1=50)

TTIA產業領袖高峰論壇 擘劃聯網願景

台北訊 2015-12-08



貴賓合影(左起：TTIA秘書長周宗保、元智大學榮譽講座教授彭松村、CYIENT半導體IDU工程部門副總Mr. Ram Gollapudi、CYIENT副總暨亞太業務總監Mr. Sujeet Kumar、SEMI Taiwan MEMS Committee Vice Chairman Mr. Giuseppe Izzo、CYIENT工程資深副總Mr. Rajendra Velagapudi、TTIA理事長許明仁、經濟部工業局副局長呂正華、台灣西門子總裁暨執行長Mr. Erdal Elver、清華-台積電卓越製造中心主持人暨清華講座教授簡禎富、CYIENT系統解決方案資深副總Dr. Venki Padmanabhan)

台北訊

台灣車載資通訊產業協會(TTIA)於2015年12月2日與美商國際半導體產業協會(SEMI Taiwan)聯合主辦的「2015產業領袖高峰論壇」，邀請產官學研各界專家共同探討以Designing Tomorrow Together為主題的產業領袖高峰論壇，2015年持續由CYIENT所贊助，自2014年開始，CYIENT就積極贊助主辦這個產業領袖高峰論壇，期望與台灣的產業界結盟，尋求雙方更大的合作空間。

2015年論壇的主題是迎接工業4.0(Industry 4.0)的挑戰與因應的策略，台灣面對內外環境轉變，大環境的經濟前景未明與景氣陷入低迷，市場快速轉變、中國與歐洲市場萎縮和紅色供應鏈的競爭，對內的景況則遇到台灣人均產值成長趨緩、少子化、高齡化的人口危機與勞動人力不足，因應全球製造業發展趨勢，為了協助台灣產業尋求加速結構優化的解決方案，借鏡工業4.0的發展，引發一股趨勢探討的熱潮。



世界各國均積極推動製造業的智慧化和創新轉型，德國是工業4.0的政策最積極的擁護者，其目標是透過發展串聯自動化、模組化與彈性生產的元件的網路技術與實體傳統製造系統的整合，來建立智慧工廠，台灣西門子公司總裁暨執行長Erdal Elver先生，提供西門子的觀點，展示義大利精品汽車製造商Maserati的個案，指出製造業所面臨效率提升、產品上市時間縮短，以及少量多樣化的彈性化生產的殷切要求與挑戰，利用產品生命週期管理(PLM)系統，透過軟體系統整合包括M2M、制定Rule Framework，以及採用虛擬的技術用以模擬產品在不同產品週期過程，進而做到全整合自動化(Total Integration Automation)目標，做為工業4.0的一個典範。相同的策略也包括美國所提出的「先進製造夥伴計畫(AMP：Advanced Manufacturing Partnership)」計畫，以及日本的人機共存未來工廠的設計，南韓的新世代智慧型工廠，連中國大陸也喊出「中國製造2025計畫」。

政府於2015年七月間旋踵也公布了生產力4.0計畫之願景與目標，該計畫希望運用雲端運算與巨量資料分析技術，整合聯網服務製造系統，希望開創一個屬於台灣產業的典範移轉。透過將生產設備智慧化，推動產業數據化，形成智慧工廠核心。再以雲端平台、大資料分析技術進一步整合製造商、通路商、供應商與消費者資料，管理產業供應鏈與發展生態系統，協助產業開發新的智慧服務，創造新的商業模式，強化台灣產業長期的成長與繁榮。

簡禎富教授在製造大未來的專題討論引言中，強調從全球的工業4.0宏觀大視角聚焦到台灣的生產力4.0計畫，在新經濟戰場的衝擊下，簡教授首先提問工業4.0是一個方法還是一個產業的目標呢？他學工業2.0到工業3.0的概念，製造業足足花了約三十年的時間，才能落實，而且台灣產業界對資本支出與投資回報的觀點不一，所以與其馬上談工業4.0的目標，不妨從另外一個簡教授所創立的工業3.5概念著手，利用一個中間階段的醞釀期來啟始新變革。

簡禎富教授舉台灣聞名的半導體產業來說明，台灣半導體產業有近三十年所積累下來的製程經驗，我們已經建構完整的上中下游生態供應鏈，這是台灣引以為傲的強項，晶圓廠透過聯網機台與自行開發的資料探勘(Data Mining)技術，透過不同的智慧型裝置與設備來收集、解譯和分析，形成智慧製程資料，將每一批可能長達一個月的晶圓製程所累積下來的巨量資料，已經發展諸如e-Manufacturing的獨立的智慧服務，並且用之積極培訓智慧員工，達到產業升級與逐步提升附加價值與生產力的成果。

CYIENT在半導體矽智財(IP)與台灣半導體產業關係密切，目前先進10奈米製程的IP與TSMC與UMC有密切的合作，其資深副總裁Venki Padmanabhan先生在論壇中舉出：印度有完全不同的產業發展的現狀，印度正面臨有2億5000萬的勞工即將投入職場，他們最缺乏的是資本投資以建立足夠的產業來收納廣大印度勞工就業的需要，如何與台灣產業結盟，有效的讓台灣的產業界投資印度，則是印度的當務之急，工業4.0的科技固然重要，但始終還是需要滿足產業的需求，才有可能被大量使用，他期望透過跨域串連整合，加速台灣與印度之間的硬、軟體跨國合作，尋求互惠雙贏的契機。

0

讚

f 分享 ([http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?](http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8c9)

[u=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8c9](http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8c9)

g+ 分享 ([https://plus.google.com/share?](https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8)

[url=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8](https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edigitimes%2Ecom%2Etw%2Fiot%2Farticle%2Easp%3Fcat%3D130%26id%3D0000453490%5F6mj5haxz8)

✉ 轉寄 ([mailto:?subject=DIGITIMES 物聯網 - TTIA產業領袖高峰論壇 擘劃聯網願景&body=DIGITIMES 物聯網文章連結：](mailto:?subject=DIGITIMES%20物聯網%20-%20TTIA%20產業%20領袖%20高峰%20論壇%20-%20擘劃%20聯網%20願景&body=DIGITIMES%20物聯網%20-%20文章%20連結%3A%20)

http://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=130&id=0000453490_6mj5haxz8c9hzi1jed6ab

🖨 列印

